

樹脂めっき用装飾電気めっきプロセス

Electroplating Process on Resin for Decorative Application

前工程からの持ち込み、後工程へ与える影響を配慮したプロセス
Less the influence by dragging-in and dragging-out

TOP DuNCプロセス

TOP DuNC PROCESS

硫酸銅めっき Acid copper plating

- エア流速が弱い箇所で発生するピットが少ない
- 硫酸銅めっきにおけるスラッジの発生が少ない
- Fewer pits at a site on low air flow rate.
- Less sludge in an acid copper bath.

硫酸銅めっきのピット
Pits after acid copper plating

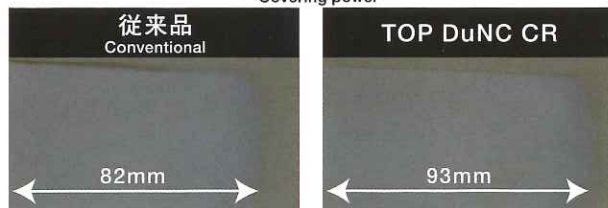


クロムめっき Chromium plating

(6価クロム)

- 付き回りが良く、陽極の溶解が少ないクロムめっき [Hexavalent chromium]
- Good covering power and less anode dissolution.

付きまわり性
Covering power

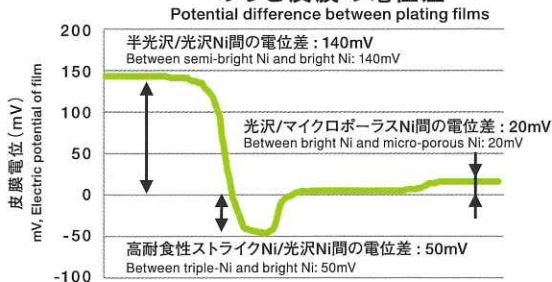


※ハルセル (5A, 2分) の被覆幅の値を測定
*Measured a plating length value at 5A for 2min. by Hull-cell test

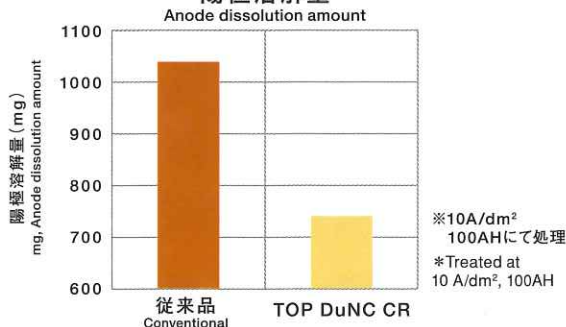
ニッケルめっき Nickel plating

- 硫酸銅めっき添加剤の持ち込みによる影響を受けにくい
- 耐食性に寄与する皮膜電位が安定に維持でき、管理が容易
- Less effect by dragging-in of acid copper plating additives.
- Can stably maintain the Ni film electric potential, which will contribute to corrosion-resistance, and easy bath control.

めっき皮膜の電位差



陽極溶解量



(3価クロム) [Trivalent chromium]

- 6価クロムに類似した白色: トップファインクロムWR
- スモーク色の黒色外観: トップファインクロムFMB
- 青黒色の黒色外観: トップファルベBLB
- White color like a hexavalent chromium plating : TOP FINECHROME WR
- Smoky black color : TOP FINECHROME FMB
- Blue black color : TOP FARBE BLB

処理工程 Process cycle

